

产品说明书

WS3401 晶片助焊剂

特点

- 可溶于水
- 经过多次再流焊/清洁后无残留物
- 保持锡球凸块形状均匀
- 不含卤化物
- 适用于锡铅，无铅和高温焊接
- 对锡球凸块下的金属化表面无侵蚀作用

简介

WS3401型晶片助焊剂 能将晶片上锡球凸块表面的氧化物清除掉。在焊料本身的表面张力作用下，它能均匀地覆盖在半球形锡球凸块上，不会侵蚀焊点，也不会出现焊锡桥接的现象。由于它的流变特性，可以用旋转或者用喷雾的方法进行涂敷。

特性

特性	测试值	测试方法
助焊剂类型:	M0	J-STD-004 (IPC-TM-650:
典型粘度:	45cst	Brookfield
表面绝缘电阻 (欧姆, 清洗后)	合格(在温度为85°C相对湿度为85%的条件下, 7天以后 $>10^9$)	IPC-B-24
典型酸度值:	68mg KOH/g	滴定
色泽	介于琥珀色与褐色之间	直接观察
保质期	6个月	0°C到+25°C

所有信息仅供参考。不用作未来产品的规范。

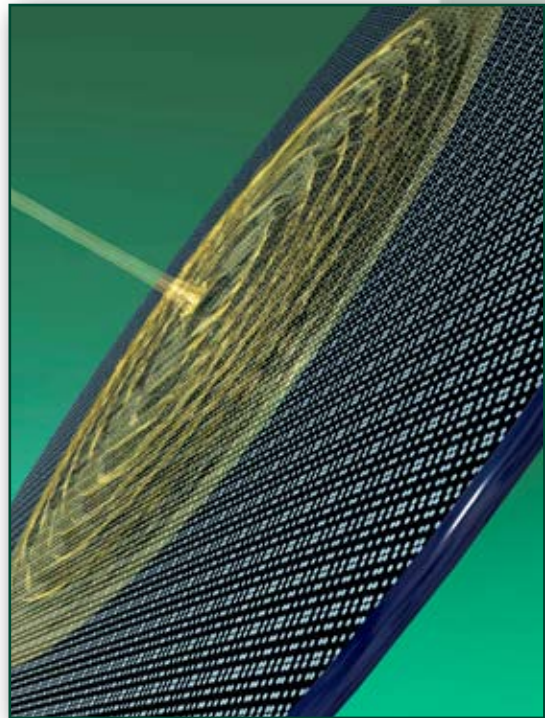
使用

旋转式涂敷: 先用某一个转速将流体助焊剂均匀地覆盖在晶片表面, 然后再用很高的旋转速度(大约2000rpm)将助焊剂打薄, 把晶片表面上多余的助焊剂去掉。

喷雾式涂敷: 喷雾器中的助焊剂储存罐应当贮有足够8小时的用量。罐内剩余的助焊剂如果存放时间过长会失效(在室温下可在罐内存放8小时以上)。喷雾器需要经常清洗, 才能有效地保证这种助焊剂或其他助焊剂的纯净度。

清洗

用室温或高于室温的去离子水或者使用加了清洗剂的水在高于60psi的压力下清洗1分钟以上。



包装

100克到3.8公升(1加仑)罐装。可根据具体要求提供其他规格的包装。

储存

WS3401的存放温度为0-25°C, 保质期可以达到最长。在超过25°C环境里存放时间不可以超过4天。储藏温度不可以超过30°C。WS3401从冷藏环境移到室温后, 在使用前应在室温下放置至少4小时。

技术支持

Indium Corporation 树立了为全球客户迅速提供现场技术支持的业界标准。Indium 公司的技术支持工程师队伍可提供材料科学和半导体封装工艺领域的各方面专业知识。

接下一页→

Form No. 98245(SC A4) R1

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
美国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册

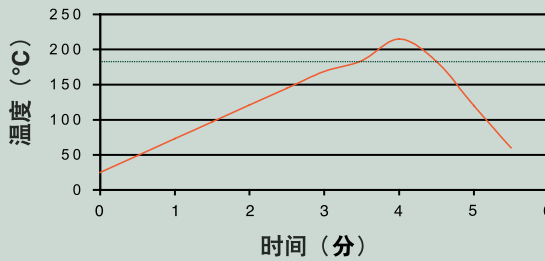
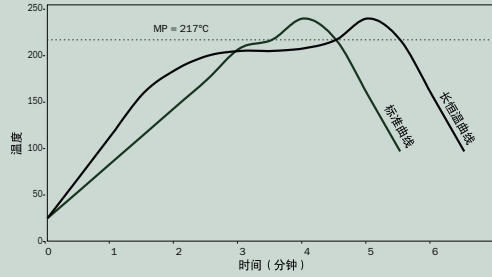
WS3401 晶片助焊剂

材料安全数据

关于本产品的材料安全数据 (MSDS), 请上网查阅, 网址: <http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>

回流

推荐的工作曲线:



再流焊

在空气或氮气 (氧气含量 < 100ppm) 中进行再流焊时, 温度先直线上升到比液相线温度高 30°C, 再流的最高温度应 < 340°C。我们建议用户从这些温度曲线开始, 根据工艺的需要对它进行优化。

此资料只是一般信息。不能保证或担保这些资料所述产品的性能, 也不可以把这些资料看作是对所述产品的保证或担

保。售出的产品只承诺随产品包装及发票所附的书面保证及有关的限制条件。

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
英国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册